

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-046

康达新材料（集团）股份有限公司

关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记

暨业绩补偿进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩补偿概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》。由于上海晶材新材料科技有限公司（以下简称“晶材科技”）2023-2025年度业绩承诺未实现，各方签订了《关于上海晶材新材料科技有限公司之业绩确认及补偿安排协议》，确认业绩承诺方本次需向公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司支付的业绩补偿款余额合计为人民币6,356.82万元，补偿方式为现金与股权形式，其中现金部分1,449.99万元，已全部支付完成；股权部分对应晶材科技8.46%的股权。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

二、进展情况

晶材科技于近日完成了工商变更登记手续。具体工商登记信息如下：

- 1、公司名称：上海晶材新材料科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GTBKY76；
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 4、注册资本：3,000万元人民币；
- 5、法定代表人：王建祥；
- 6、公司住所：上海市闵行区中春路1288号6幢102、202、302、402室；
- 7、成立日期：2016年05月10日；
- 8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资金额 (万元)
1	北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司	88.8637%	2,665.91
2	上海卡翱企业管理合伙企业（普通合伙）	9.0000%	270.00
3	重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（普通合伙）	1.8180%	54.54
4	上海晶敖科技合伙企业（普通合伙）	0.3183%	9.55
合计		100%	3,000.00

9、经营范围：从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子浆料、粉体、膜带的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次工商变更登记完成后，基于晶材科技2023-2025年度业绩完成情况应实施的业绩补偿已履行完毕。

三、备查文件

1、上海晶材新材料科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月六日